

プラナリゼーション CMP とその応用(1)

3月17日 9:20~10:20 E室

E62

グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発 (第 11 報) —ダイラタンシー・パッドによる摩擦仕事率と加工特性の相関—

○瀬下 清・土肥俊郎・山崎 努・大坪正徳・菅野俊彦 (九州大) ・佐伯 卓 (フジボウ愛媛) ・宮下忠一 (不二越機械工業)

E63

フェムト秒レーザーを用いた半導体ウェハ表面のコヒーレントフォノン励起加工に関する研究 (第 3 報) —表面励起効果の検討—

○林 照剛・横尾英昭・松永啓伍・松川洋二・王 成武・黒河周平 (九州大)

E64

鏡面創成のための多孔質ビトリファイドボンド砥石の作製と特性評価

○永嶋雅俊・佐野侑希・山田洋平・池野順一 (埼玉大)

プラナリゼーション CMP とその応用(2)

3月17日 10:40~12:00 E室

E66

シリコン研磨における高研磨レートパッドについて

○阪口拓哉・綱島祥隆・森岡善隆・大嶋伸之 (ニッタ・ハース)

E67

難加工基板の CMP を対象とした研磨パッド表面性状と研磨レートの関係

○松永敬弘・畝田道雄 (金沢工大) ・澁谷和孝・中村由夫・市川大造 (不二越機械工業) ・石川憲一 (金沢工大)

E68

先端的難加工基板の高効率精密加工法の研究 (第 6 報) —fs レーザ照射による疑似ラジカル場形成基板表面の CMP 研磨特性—

○黒河周平・王 成武・土肥俊郎 (九州大) ・佐野泰久 (大阪大) ・會田英雄 (九州大, 並木精密宝石) ・大山幸希 (並木精密宝石) ・林 照剛・吹春 昇 (九州大)

E69

フレキシブルファイバーコンディショナを用いた研磨パッドの表面性状再生技術とその機構解明の研究

○高橋直紀・畝田道雄 (金沢工大) ・新井雄太郎 (昭和工業) ・藤田 隆 (東京精密)

プラナリゼーション CMP とその応用(3)

3月17日 13:00~14:00 E室

E73

光電気化学酸化を援用した触媒表面基準エッチング法による炭化ケイ素の高効率平坦化

○稲田辰昭・磯橋 藍・佐野泰久・山内和人（大阪大）

E74

プラズマエッチングによる基板の基準面加工法の開発

○宮崎俊巨・佐野泰久・松山智至・山内和人（大阪大）

E75

マイクロ流路を用いた層流下の銅腐食観察—電極電位測定—

○大場森暁（東京理科大） ・大保忠司・嶋 昇平・濱田聡美（荏原製作所） ・早瀬仁則（東京理科大）

プラナリゼーション CMP とその応用(4)

3月17日 14:20~15:40 E室

E77

蛍光ナノプローブを用いたブラウン運動解析に基づくナノ粒子粒径計測

○林 照剛・世利俊樹・黒河周平（九州大）

E78

ポリシング前後におけるスラリー中の研磨微粒子径に関する研究

○永井利幸・八尋 新・カチヨンルンルアンパナート・鈴木恵友（九工大）

E79

CMPにおけるウェーハ・研磨パッド間スラリー流れの可視化（第2報）—パッド摩耗の影響の可視化に関する試み—

○福田 明・石田 士・潮田拓海（徳山高専）

E80

両面研磨におけるウェーハ挙動の解析技術の開発

○橋本洋平・近藤亮太・古本達明・小谷野智広・細川 晃（金沢大）

プラナリゼーション CMP とその応用(5)

3月17日 16:00~17:00 E室

E82

革新的 CMP/P-CVM 融合装置の設計・試作（第10報）—基本型装置（A型）によるダイヤモンドの加工—

○佐野泰久（大阪大） ・土肥俊郎・黒河周平（九州大） ・會田英雄・大山幸希（九州大，並木精密宝石） ・宮下忠一・住澤春男（不二越機械工業） ・宮崎俊巨・山内和人（大阪大）

E83

革新的 CMP/P-CVM 融合加工装置の設計・試作（第11報）—B-Type 装置による GaN 基板加工特性とその加工メカニズム—

○大山幸希（九州大, 並木精密宝石） ・ 西澤秀明・土肥俊郎（九州大） ・ 會田英雄（九州大, 並木精密宝石） ・ 金 聖祐（並木精密宝石） ・ 佐野泰久（大阪大） ・ 黒河周平（九州大） ・ 山崎直樹（並木精密宝石）

E84

革新的“Plasma fusion CMP 装置”の設計・試作（第 12 報）—B-type 装置によるダイヤモンド基板の高効率加工とその加工メカニズム—

○西澤秀明・土肥俊郎（九州大） ・ 大山幸希・會田英雄（九州大, 並木精密宝石） ・ 佐野泰久（大阪大） ・ 黒河周平（九州大） ・ 金 聖祐（並木精密宝石）